



## 【東京/武蔵村山】機械設計（半導体製造装置） ◆ヤマハ発動機グループ

ヤマハロボティクス株式会社での募集です。 機械設計・機構設計・筐体設計・メカト...

### Job Information

#### Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

#### Hiring Company

ヤマハロボティクス株式会社

#### Job ID

1594517

#### Industry

Electronics, Semiconductor

#### Job Type

Permanent Full-time

#### Location

Tokyo - Other Areas

#### Salary

4.5 million yen ~ 7.5 million yen

#### Work Hours

08:45 ~ 17:30

#### Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 採用月に応じて2日～15日 4か月目から 【休日】完全週休二日制...

#### Refreshed

May 28th, 2026 16:23

### General Requirements

#### Career Level

Mid Career

#### Minimum English Level

None

#### Minimum Japanese Level

Native

#### Minimum Education Level

Technical/Vocational College

#### Visa Status

Permission to work in Japan required

### Job Description

【求人No NJB2335265】

#### MISSION

半導体製造装置（ボンディング装置）メーカーである同社において、機械設計職の募集です。

[取扱い製品]

ワイヤボンダ、ダイボンダ、パンパボンダ、フリップチップボンダ、等

半導体製造装置の新機種開発、カスタマイズ設計をご担当いただきます。  
顧客要望のヒアリングから仕様検討、設計、出図業務、試運転立ち合いまで一貫してかかわることができるのが魅力です。

※残業想定時間：20時間程度を想定

#### ■半導体ボンディング装置のパイオニア企業

1970年代後半、それまで人の手で行われていたワイヤボンディング（半導体製造における後工程作業）の全自動化に成功したのは当社です。競争が増えた今、当社の強みは品質No.1であり仕様に沿ってカスタマイズ設計ができること。この丁寧さは今後も捨てずに、日本企業としての自信・自負をもって世界No.1であり続けるのが私たちの目標です。

#### □主力製品「フリップチップボンダ」について

半導体製造のための精密ロボットです。  
ウェハー上に形成された半導体素子を、反転（フリップ）させて基板上  
もしくはウェハー上へボンディングする為の装置で、従来のワイヤボンディングに  
替わる新しい実装技術になります。  
最新のスマートフォンやデータセンタの中心的な役割を果たすICを  
製造する為の装置です。  
メカトロニクス技術はもちろん、制振制御、ロボティクス、材料工学、  
画像処理技術などあらゆる最先端の技術がつまっています。

#### Required Skills

##### 【必須条件】

- ・機械装置、産業機器の設計や駆動系開発のご経験

#### Company Description

ヤマハロボティクス株式会社（Yamaha Robotics Co. Ltd.）は、ヤマハ発動機株式会社グループにおいて半導体製造装置（後工程）および電子部品組み立て装置事業を担う会社です。